

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W1XW036N035W	文件编号	临时
	稳压二极管	版本号	18-A1-06
		页码	1/2

1 主要用途及主要特点

1.1 主要用途

用 W1XW036N035W 封装的成品管主要用于稳压电路与 ESD 保护。

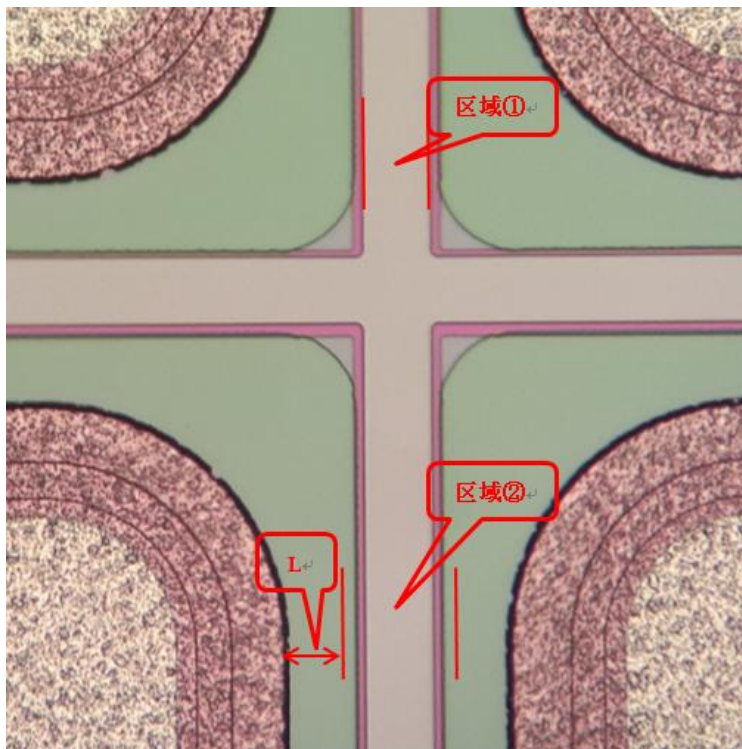
1.2 主要特点

- 高 ESD 能力
- 低温度系数
- 高可靠性

2 芯片数据

芯片示意图	芯片尺寸 (mm×mm)	0.35×0.35		
	芯片厚度 (μm) (推荐)	≤170		
	*划片道尺寸 (μm)	46		
	键合区面积 (μm ²)	正面	150×150	
		背面		
	正面电极 (阳极)	金属	铝	
		厚度 (μm)	5.0±1.0	
	背面电极 (阴极)	表层金属	金	银
	装片要求 (推荐)		共晶	低温共晶
	硅片直径 (mm)	φ125		
键合要求 (推荐)	铜丝; φ32 μm; 一根			

* 划片道位置示意图:



备注: 区域①为划片刀走刀区域, 划片时应在两条参考线中间; 区域②为划片道区域, 宽度为 46 μm; 划片时划片道边缘到铝的距离 L 不小于 20 μm 即判定为合格。

江阴新顺微电子有限公司

地 址: 江苏省江阴市长山大道 78 号
电 话: (0510) 86851182

网址: <http://www.xs-elec.com>
传真: (0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W1XW036N035W	文件编号	临时
	稳压二极管	版本号	18-A1-06
		页码	2/2

3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

3.1 极限值

除非另有规定, $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	额定值	单位	备注
结温	T_j	150	$^{\circ}\text{C}$	推荐封装形式: SOD-123 推荐成品型号: MMSZ4685
贮存温度	T_{stg}	-65~150	$^{\circ}\text{C}$	

3.2 电参数

除非另有规定, $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
稳压电压	V_Z	$I_Z=50\mu\text{A}$	3.42	3.6	3.78	V
反向电流	I_R	$V_R=2\text{V}$	—	—	7.5	μA
正向电压	V_F	$I_F=10\text{mA}$	—	—	0.9	V

3.3 典型特性曲线

暂无

注意事项:

- 芯片存储条件(推荐): 氮气保护, 温度 $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$, 湿度 $\leq 45\%$;
- 本产品说明书仅供参考, 不作为合同的一部分, 具体以双方签订的技术协议为准;
- 本产品说明书如有版本变更, 恕不另行告知! 客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新;
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能, 买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施, 以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号
电话: (0510) 86851182

网址: <http://www.xs-elec.com>
传真: (0510) 86851532